

# 華夏科技大學專利與設計申請及技術移轉管理辦法

96年11月06日本校96學年度第1學期第2次行政會議通過  
98年02月17日本校97學年度第2學期第1次行政會議修訂通過  
98年08月13日本校98學年度第1學期第1次行政會議修訂通過  
99年10月14日本校99學年度第1學期第3次行政會議修訂通過  
100年02月24日本校99學年度第2學期第1次行政會議修訂通過  
103年8月21日本校103學年度第1學期第1次行政會議修訂通過  
104年06月03日本校103學年度第2學期第4次行政會議修訂通過

- 第一條 目的  
本校為鼓勵創新及提升研究水準，並有效管理及運用教師之研究發展成果暨創作（以下簡稱研發成果），訂定「華夏科技大學專利與設計申請及技術移轉管理辦法」（以下簡稱本辦法）。
- 第二條 本校專任教師利用本校資源完成之研究而衍生之發明(創作)，其智慧財產權之歸屬依中華民國法令定之。其專利申請與維護、技術移轉與授權，及權益分配依本辦法辦理。如有未盡事宜，依其他相關法令規定辦理。
- 第三條 承辦單位  
本校研發成果及技術移轉與授權之承辦單位為研究發展處（以下簡稱研發處）。
- 第四條 專利申請與補助  
一、創作人需填具申請書。  
二、需經審查委員三分之二推薦。  
三、補助經費包括辦理專利申請至領證之各項政府規費。  
四、補助之專利申請人為「華夏科技大學」，專利發明人為原創作之專任教師(群)與學生。  
五、費用補助範圍包含「發明」專利、「新型」專利及「設計」專利。  
六、備齊申請文件並依照行政流程簽准後，始可核銷。
- 第五條 本修正案通過前之申請案仍依原辦法補助專利經費至領證或核駁為止。
- 第六條 申請人為專任教師(群)時，可自費提出申請，獲准專利後其智慧財產權若允讓與本校，其補助方式依第四條辦理，以原保留之原始憑證、專利說明書等做為佐證資料申請補助。
- 第七條 每位教師(第一發明人)每年度申請補助總經費以十萬元為限。
- 第八條 補助的專利申請案(智慧財產權為本校)，研發成果簽約金、授權金及其他衍生利益之分配，依發明人百分之八十、學校百分之二十(系所百分之五)比率分配。
- 第九條 本校教師之創作(智慧財產權為專任教師或群)，得將其創作交由研發處代為技術移轉或授權使用，成功後之簽約金、授權金及其他衍生利益之分配，依發明人百分之八十五、學校百分之十五比率分配。
- 第十條 屬於本校自有之專利者，於維護期滿後原則上不再繼續維護，如有技術移轉、授權或其他衍生利益者，可提出申請，由學校補助維護年費。本校放棄維護後，得將該專利權讓與有意繼續

- 維護之發明人，由發明人自行負擔轉讓費、登記費及後續維護年費。
- 第十一條 本校專利權受侵害時，由本校統一處理，本校各單位及發明人應全力協助之。
- 第十二條 發明人之義務
- 一、由本校委託事務所代辦申請專利時，發明人應無償提供必要之資料與說明，並協助事務所人員撰寫申請專利說明書及相關文件。
  - 二、發明人於專利案之申請、審查、異議、訴願、行政訴訟及司法訴訟等法律程序中應對其發明內容負答辯之責任。
  - 三、發明人應配合實施該發明之技術移轉、推廣應用。
  - 四、發明人因抄襲等不法手段獲得專利，以致侵害他人權益時，發明人應負一切責任。
- 第十三條 凡利用本校資源完成之研究成果不論取得專利與否，均應採取保護措施，並適時尋求技術移轉或授權及商品化之機會。
- 第十四條 發明文件管理及保密義務
- 一、研發人員及參與研究之人員應詳實填寫與發明有關之資料於研究紀錄中，並揭露發明予本校。
  - 二、本校於收受機密文件或非機密文件時，應載明交付之資訊文件項目，承辦人並應定期建檔更新，以建構本校研發成果資料庫。
  - 三、對於列為秘密之計畫、文件、圖表等，相關研發人員及行政業務承辦人應課以守密義務，不得洩漏，並妥善保存相關資料；如因自己過失洩漏或知悉他人洩漏時，應即告知本校。
  - 四、本校教師於聘約終止後兩年內，非經書面同意，不得利用本校列為機密之資料，為自己或他人從事或經營有損本校權益之虞之行為。
  - 五、相關承辦人對於資料之流通、銷毀應嚴守保密原則。
- 第十五條 本辦法經行政會議通過，校長核定後公布實施；修正時亦同。

# 華夏科技大學申請補助專利費用資料表

填表日期：      年      月      日

教師姓名：		所屬系所	
技術中文名稱：			
技術英文名稱：			
共有單位名稱：			
專利類別：	<input type="checkbox"/> 發明 <input type="checkbox"/> 新型 <input type="checkbox"/> 新式樣	申請補助費用	元
發明人 (創作人) (可以多筆)	<b>姓名</b>	<b>身份證字號</b>	
產業別(可複選，最多只能選 5 個)：	<input type="checkbox"/> 積體電路產業 <input type="checkbox"/> 電腦及週邊產業 <input type="checkbox"/> 通訊產業 <input type="checkbox"/> 光電產業 <input type="checkbox"/> 精密機械產業 <input type="checkbox"/> 機械設備製造業 <input type="checkbox"/> 自動化機具業 <input type="checkbox"/> 製藥工業 <input type="checkbox"/> 農藥工業 <input type="checkbox"/> 生物技術產業 <input type="checkbox"/> 食品製造業 <input type="checkbox"/> 化學材料製業 <input type="checkbox"/> 化學製品製造業 <input type="checkbox"/> 金屬製品製造業 <input type="checkbox"/> 非金屬製品製造業 <input type="checkbox"/> 電子產業 <input type="checkbox"/> 其他		
技術中文內容			
技術應用範圍：	【範例:本專利具產業利用性，在光電通訊技術領域如手機、PDA 均可應用本技術。】		
市場潛力：	【範例:預估在手機、PDA 等消費市可提高市場佔有率。】		
檢附資料：	<input type="checkbox"/> 專利前案檢索資料。 <input type="checkbox"/> 申請專利說明書 1 份。 <input type="checkbox"/> 申請專利切結書 1 份。 <input type="checkbox"/> 專利/法律事務所報價單 1 份。 <input type="checkbox"/> 其他。		

※表格不足自行延伸

## 華夏科技大學專利申請自行研發切結書

專利申請案編號：\_\_\_\_\_

立切結書人為華夏科技大學\_\_\_\_\_系/所（職稱）\_\_\_\_\_

（姓名）\_\_\_\_\_等研究團隊，於在校期間所研發產出之技術「\_\_\_\_\_」（以下簡稱本專利），同意以華夏科技大學（以下簡稱本校）名義申請各國發明專利，立切結書人爰聲明並保證如下：

1. 立切結書人擔保本專利僅利用本校校內資源自行研發，未利用任何政府機關補助計畫與經費；且本專利係立切結書人於本校服務期間所研發，非立切結書人於其他單位服務期間之研發產出者。
2. 立切結書人保證其所提供之本專利申請資料正確無誤，並無任何冒充、抄襲、模仿、影射或其他不實情形。
3. 立切結書人同意遵守本校專利申請相關規範並配合本校辦理一切專利申請、推廣運用之必要程序。
4. 立切結書人聲明若有違反上述一至三點，導致本校產生相關額外費用支出或遭致第三人求償，立切結書人同意自行負擔該相關額外費用及賠償金，並負擔其所肇生之不利影響。

立切結書人 (所有發明人)	戶籍地址	身份證字號	簽章

（發明人簽署欄位不足請自行增列）

中 華 民 國 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日